Ionenstrahlglättung von Si-Oberflächen: Grundlagen und Anwendungen

Frank Frost und Bashkim Ziberi

Leibniz-Institut für Oberflächenmodifizierung e. V.

Permoserstr. 15, D-04318 Leipzig frank.frost@iom-leipzig.de www.iom-leipzig.de



Motivation

- Überblick zur Entwicklung von Si-Oberflächen bei der niederenergetischen Ionenstrahlerosion
- (lineares) Modell zur Entstehung spezifischer Oberflächentopographien
- Aufklärung der dominierenden Relaxationsprozesse
- Schlussfolgerungen



• komplexe Prozesse bei der Ionenstrahlerosion von Festkörperoberflächen: Aufrauhung, Glättung, Musterbildung, ...

 Ar⁺ — Si: einfaches aber auch technologische bedeutendes Modellsystem

• Verständnis der grundlegenden Prozesse unvollständig

 Optimierung und Anpassung der Ionenstrahl(direkt)glättung an technologische und ökonomische "Randbedingungen"



Überblick (I): niederenergetische Ionenerosion von Si



4



modifizierung e.V.

Überblick (II): niederenergetische Ionenerosion von Si





e.V.

Modellierung der OF-Entwicklung: Kontinuumsansatz





6

l eibniz-Institut f

e V

Lineares Modell ($\lambda = 0$)

 $|h(q,t)^{2}| = PSD(q = 2\pi f,t) =$ $PSD_{0}(q) \times \exp\left\{-\left(Vq + Sq^{2} + Dq^{4}\right)t\right\} + A\frac{1 - \exp\left\{-\left(Vq + Sq^{2} + Dq^{4}\right)t\right\}}{Vq + Sq^{2} + Dq^{4}}$

Eigenschaften der "power spectral density funtion" PSD(f, t):

•
$$\int PSD(f,t) 2\pi f df = R_q^2(t) \dots \text{ rms}$$
 - Rauheit

• wenn Glättung dominiert ($Vq + Sq^2 + Dq^4 > 0$):

$$PSD(f, t \to \infty) \to A/(Vq + Sq^2 + Dq^4)$$



Kinetik der Glättung

8





Leibniz-Institut für Oberflächenmodifizierung e.V.

IOM

Kinetik der Glättung



$$PSD(f, t \to \infty) = \frac{A}{Sq^2} \sim q^{-2}$$
 krümmungsabhängige Relaxation?

Leibniz-Institut für Oberflächen-ΙωΜ

modifizieruna e.V.

1. Krümmungsabhängige Abtragsrate:

$$S = \frac{j_{ion}a}{N}Y(\alpha_{ion})[\Gamma_1(\alpha_{ion}) + \Gamma_2(\alpha_{ion})] (= ER \times a[\Gamma_1(\alpha_{ion}) + \Gamma_2(\alpha_{ion})]) < 0 \text{ für } \alpha_{ion} < 50^\circ$$

2. Ballistische Drift*:

atomare Drift parallel zur Oberfläche durch Impulseintrag ($\alpha_{ion} > 0^{\circ}$)

$$F(s) = j_{ion} \cos(\alpha_{ion} - \gamma) f(E) d \sin(\alpha_{ion} - \gamma)$$
$$S = \frac{j_{ion}}{N} f(E) d \cos(2\alpha_{ion})$$

3. Krümmungsabhängige Relaxation:

$$S = \frac{j_{ion}}{N} [f(E)d\cos(2\alpha_{ion}) + aY(\alpha_{ion})\Gamma_{av}(\alpha_{ion})]$$

* G. Carter, PRB 1996, Vacuum 1998



Krümmungsabhängige Relaxation

Momentum deposition by heavy ion bombardment (Littmark & Sigmund 1975)

 $P_{x'}$ P_{y} : momentum density normal/parallel to surface







$$S(\alpha_{ion}) = \frac{j_{ion}}{N} [f(E)d\cos(2\alpha_{ion}) + a(\alpha_{ion})Y(\alpha_{ion})\Gamma_{av}(\alpha_{ion})]$$

$$g(\alpha_{ion}) \approx const.$$

$$PSD(q,t) = PSD_{0} \times \exp\{-Sq^{2}t\} + A \frac{1 - \exp\{-Sq^{2}t\}}{Sq^{2}}$$

Relaxationszeit: $T_R = 1/Sq^2 \sim 1/cos(2 \alpha_{ion})$





Leibniz-Institut für IOM Oberflächenmodifizieruna

e.V.



XI. Erfahrungsaustausch "Oberflächentechnologie mit Plasma- und Ionenstrahlprozessen", Mühlleithen, 02.-04.03.2004







Ballistische Drift ohne ballistische Diffusion?

1. Ballistische Drift:

gerichtete atomare Drift parallel zur Oberfläche durch Impulseintrag ($\alpha_{ion} > 0$)

$$S = \frac{\dot{J}_{ion}}{N} f(E) d \cos(2\alpha_{ion})$$

2. Ballistische Diffusion:

ungerichtete Bewegung von rückgestoßenen Atomen transversal zur Einschußrichtung

$$\langle d \rangle = 0$$

aber
 $\langle d^2 \rangle \neq 0$

$$D = \frac{j_{ion} 0.067 F_{n0} d^2 n a \Gamma_{av}(\alpha_{ion})}{NE_{d}}$$







Ballistische Drift und ballistische Diffusion





17

(Einige) Schlussfolgerungen

Allgemein:

- niederenergetische (Ar⁺)-Ionenstrahlen sind ein geeignetes Werkzeug zur Glättung von Oberflächen (Si, Quarz, versch. Halbleiter, SiC, Cu, Diamant, …)
- minimal erreichbare Rauheit bei Glättung ist bestimmt durch die Stochastik des Erosionsprozesses, bei ballistische Drift als dominierenden Relaxationsprozeß gilt:

$$R_q(t \to \infty) = \sqrt{A_s} \ln \left(f_{\max} / f_{\min} \right)$$

Speziell für Si:

• atomare Drift ist ein sehr effektiver Glättungsprozess für kleine Ortsfrequenzen:

z.B: $D = S_r f = 10^{-3} \text{ nm}^{-1} \rightarrow T_R(\text{Drift}) / T_R(\text{Diffusion}) = 10^{-6})$

• ballistische Drift als Relaxationsprozeß ist am effektivsten für senkrechten Ioneneinfall (technologisch günstig)

aber: "parasitäre" Prozesse

